



## HST-OSP 106

本品属于第五代咪唑类产品，应用于印制电路板铜表面处理技术（OSP）的一种主要功能性原材料，适用于**单面**和**双面板**，属于**乐思 106A** 系列主成膜剂 **CBBI**。

化合物类型：取代基咪唑类

外观：白色或类白色粉末                      含量：≥99.5%

## HST-OSP HT

本品属于第五代咪唑类产品，应用于印制电路板铜表面处理技术（OSP）的一种主要功能性原材料。用于**双面**、**多层**、**无铅**以及**选化板**，其熔点明显增加，与铜的结合力更加紧密，**耐高温**，可焊性好。属于**乐思 HT** 系列主成膜剂 **DCBI**。

化合物类型：取代基咪唑类

外观：白色或类白色粉末                      含量：≥99.5%

## HST-OSP F2

本品属于第五代咪唑类产品，无卤素，应用于印制电路板铜表面处理技术（OSP）的一种主要功能性原材料，**耐高温**，可焊性好。使用于**双面**、**多层**、**无铅**以及**选化板**。属于**四国化成 F2** 系列主成膜剂。

化合物类型：苯基咪唑衍生物

外观：白色或类白色粉末                      含量：≥99.5%

## HST-OSP F3 Plus

本品属于第五代咪唑类产品，应用于印制电路板铜表面处理技术（OSP）的一种主要功能性原材料，**耐高温**，可焊性好。使用于**双面**、**多层**、**无铅**以及**选化板**。属于**四国化成 F3** 系列主成膜剂。

化合物类型：苯基咪唑衍生物

外观：白色或类白色粉末                      含量：≥99.5%

